

2019年 SEMICON JAPAN 参加報告書

群馬大学 理工学部 電子情報理工学科
小林研究室 学部4年 Isam Ebisawa Kuswan

1. 概要

SEMICON JAPAN2019

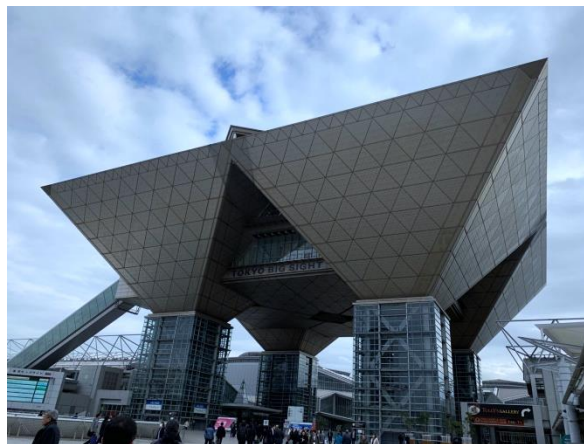
<https://www.semiconjapan.org/jp/>

開催期間：2019年12月11日(水)～13日(金)

開催場所：東京ビックサイト

2. 感想

東京ビックサイトで行われた SEMICON Japan は、半導体の前工程～後工程までの全工程から、自動車やIoT機器などの SMART アプリケーションまでをカバーする、エレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会である。約700社が最先端の製造技術を展示し、約2万5000人の参加者が世界中から集まってくる。



企業の展示以外にも、群馬大学を含む多くの大学機関や高等専門学校が全国から集いポスター形式で研究についての研究発表も行われた。また、オランダ、ドイツ、TOHOKU、九州による地域パビリオンの展示などもあった。

会場の展示ゾーンでは「前工程ゾーン」、「後工程・総合ゾーン」、「部品・材料ゾーン」、「SMART Applicationsゾーン」に分かれており、半導体製品の設計から製造まで階層やホールで区切られていた。また、大学生・大学院生のための半導体業界研究イベントの「未来COLLAGE」が行われていた。



このイベントは出展企業が学生に向けて半導体業界について説明し、就職活動などについてのお話を聞くことができる。私はOBが何人か就職しているアドバンテスト社をはじめ、マイクロン社や東京エレクトロン社などにお伺いし多くの半導体メーカーさんからお話をお伺いすることができ、大変参考になった。

3. 謝辞

今回の SEMICON JAPAN のイベントを招待していただき、またポスター展示のために研究のご指導を頂いた小林春夫先生、参加するにあたって支援をいただいた桑名杏奈先生をはじめ、一緒に参加した小林研究室の皆様へ深く感謝を申し上げます。

